

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局(43) 国際公開日
2007年11月15日 (15.11.2007)

PCT

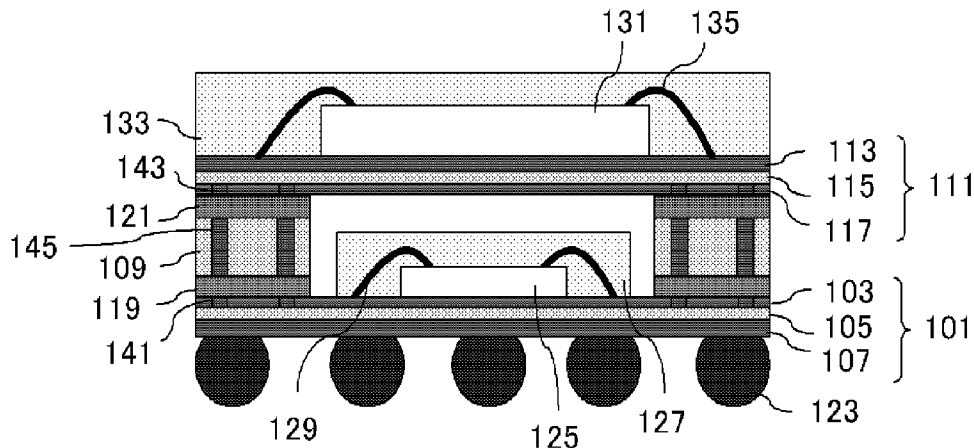
(10) 国際公開番号
WO 2007/129458 A1

- (51) 国際特許分類:
H01L 25/10 (2006.01) H01L 25/18 (2006.01)
H01L 25/11 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2007/000443
- (22) 国際出願日: 2007年4月24日 (24.04.2007)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願2006-123461 2006年4月27日 (27.04.2006) JP
特願2006-166162 2006年6月15日 (15.06.2006) JP
特願2006-192658 2006年7月13日 (13.07.2006) JP
特願2006-195178 2006年7月18日 (18.07.2006) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 住友ベークライト株式会社 (SUMITOMO BAKELITE CO., LTD.) [JP/JP]; 〒1400002 東京都品川区東品川 2丁目 5番 8号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および
(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 杉野光生 (SUGINO, Mitsuo) [JP/JP]; 〒1400002 東京都品川区東品川 2丁目 5番 8号 住友ベークライト株式会社内 Tokyo (JP). 桂山悟 (KATSURAYAMA, Satoru) [JP/JP]; 〒1400002 東京都品川区東品川 2丁目 5番 8号 住友ベークライト株式会社内 Tokyo (JP). 山代智絵 (YAMASHIRO, Tomoe) [JP/JP]; 〒1400002 東京都品川区東品川 2丁目 5番 8号 住友ベークライト株式会社内 Tokyo (JP). 宮本哲也 (MIYAMOTO, Tetsuya) [JP/JP]; 〒1400002 東京都品川区東品川 2丁目 5番 8号 住友ベークライト株式会社内 Tokyo (JP). 山下浩行 (YAMASHITA, Hiroyuki) [JP/JP]; 〒1400002 東京都品川

/ 続葉有 /

(54) Title: SEMICONDUCTOR DEVICE AND SEMICONDUCTOR DEVICE MANUFACTURING METHOD

(54) 発明の名称: 半導体装置および半導体装置の製造方法



(57) Abstract: A semiconductor device (100) includes a first resin board (101) having a first semiconductor chip (125) mounted on the surface; a second resin board (111) having a second semiconductor chip (131) mounted on the surface; and a resin base material (109) which is bonded on the front plane of the first resin board (101) and on the rear plane of the second resin board (111) for electrically connecting the boards. The resin base material (109) is arranged on the outer circumference of the first resin board (101) on the front plane of the first resin board (101). Furthermore, on the front plane of the first resin board (101), the first semiconductor chip (125) is arranged in a space arranged by the first resin board (101), the second resin board (111) and the resin base material (109).

(57) 要約: 半導体装置 (100) は、表面に第一半導体チップ (125) が搭載された第一樹脂基板 (101)、表面に第二半導体チップ (131) が搭載された第二樹脂基板 (111)、および第一樹脂基板 (101) の表面および第二樹脂基板 (111) の裏面に接合されて、これらを電氣的に接続する樹脂基材 (109) を含む。樹脂基材 (109) は、第一樹脂基板 (101) の表面において第一樹脂基板 (101) の外周に配置される。また、第一樹脂基板 (101) の表面において、第一樹脂基板 (101) と第二樹脂基板 (111) と樹脂基材 (109)

/ 続葉有 /



WO 2007/129458 A1



区東品川2丁目5番8号住友ベークライト株式会社
社内 Tokyo (JP).

(74) 代理人: 速水進治 (HAYAMI, Shinji); 〒1500021 東京都渋谷区恵比寿西2-17-16 代官山TKビル
1階 Tokyo (JP).

(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SV, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD,

SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

規則4.17に規定する申立て:

- 出願し及び特許を与えられる出願人の資格に関する申立て (規則4.17(ii))
- 発明者である旨の申立て (規則4.17(iv))

添付公開書類:

- 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。